

2018 상반기 LG전자 신입사원 정시채용

● 지원 자격

- 대상** 2018년 8월 졸업 예정자 및 기졸업자 (학사/석사/박사)
학위 국내/해외에서 학사/석사/박사 또는 이와 동등한 효력이 인정되는 자격을 취득(예정)한 자
병역 군필자 또는 면제자에 한함
어학 자사 기준에 준하는 공인 영어 성적 보유자 (서류 접수 마감일 기준 2년 이내 유효 성적에 한함, 단 영어권 국가의 4년제 해외대 학위 취득자는 어학 성적 제출 대상에서 제외)

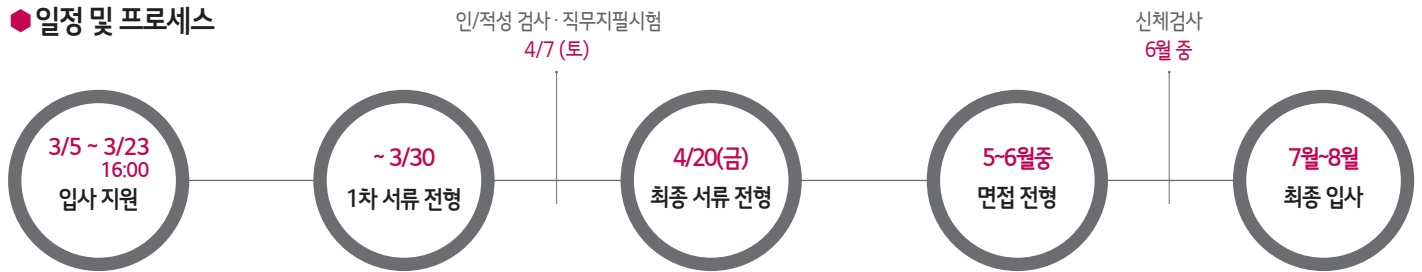
해당 직무	TOEIC	TOEIC Speaking	OPIc
Sales, Finance	700이상	Level 6 이상	IM 이상

※ OPIc 등급 중 IM 등급은 IM1, IM2, IM3으로 나누어 입력함
 ※ 상기 직무 외에는 어학 점수를 입력하여도 서류전형에 반영되지 않습니다. 단, 면접 대상자에 한하여 별도 어학 성적을 요청 또는 자체 어학 Test를 실시할 예정입니다.

기타

- 해외 여행에 결격 사유가 없는 경우에 한함
- 산학장학생은 별도 모집 프로그램으로 선발함
- 입사지원서 및 채용 전형 과정에서 허위 사실이 발각될 경우는 입사가 취소될 수 있음
- 졸업예정자의 경우 입학 후 3개월 내 학위증명서를 제출하지 못할 시 입사가 취소될 수 있음
- 취업 보호 대상자(보훈 대상자/장애인)는 관련 법규 등에 의거하여 우대함
 ※ 면접 또는 최종 합격시 해당 증명서 제출자에 한함

● 일정 및 프로세스



1차 서류 전형 입사지원서를 기준으로 지원 분야에 해당하는 필요 역량을 갖추었는지를 판단

인/적성 검사 LG Way 와의 적합성 확인 및 언어/수리 등 기본 역량 평가

구분	검사 내용	문항 수	소요 시간
인성검사 (LG Way Fit Test)	지원자와 LG Way 간의 적합성 확인	342문항	50분
적성 검사*	언어이해/ 언어추리/ 인문역량/ 수리력/ 도형추리/ 도식적추리	125문항	140분

* 문항예제는 careers.lg.com에서 확인할 수 있습니다.

직무지필시험 기본적인 직무 능력을 갖추었는지를 평가

직무	검사 내용	문항 수	소요 시간	응시일
R&D_SW	C, JAVA 프로그래밍 관련	70 문항	110분	4월 7일(토) 인/적성 검사와 동일한 날 실시
R&D_HW	전기공학, 전자공학	80문항	100분	
R&D_기구	기계공학	40문항	50분	
Finance	기초회계 관련	20문항	60분	

면접 전형 직무별 다양한 모듈을 통해 지원자의 직무/인성을 종합적으로 평가

구분	검사 내용
직무 면접	직무 지식 및 직무 적합도 검증
인성 면접	LG Way 형 인재 검증

LG Electronics Recruiting

◆ 지원 분야

본부	직무	주요 업무/역할	관련 전공						근무지
			전기/전자	기계	컴퓨터/SW	소재/재료	경영/경제	기타 전공	
H&A사업본부 (Home appliance & Air solution)	R&D_기구	- 열 유체 유동설계, 구조 설계, 해석 (응용역학, CAD/CAE/CAM, 최적설계) - 강성, 동역학, 피로해석, 진동/소음 분석 및 평가 등		●		●			서울/창원
	R&D_HW	- Sensor Application, 구동 Drive, 모터 응용 설계(전동기 설계 및 제어, 인버터, IH) 등	●						서울/창원
	R&D_SW	- 시스템 알고리즘 (지능제어, 신호처리), Smart 기술 등 - 로보틱스(Robot Tech, Mapping&Navigation, Robust SLAM, Vision&Sensor)	●		●				서울/창원
MC사업본부 (Mobile Communications)	R&D_HW	- RF/Antenna설계: RF 회로 설계, Antenna 패턴/매칭 설계, ESD/EMC 저감 설계 - Processor 회로설계: Baseband/주변 회로 설계, HW 성능분석 및 개선 - Analog Circuit 회로설계(Connectivity, Core Component 적용 및 성능 개선) - Packaging 기술개발: 고밀도 실장 PCB 설계, 부품별 최적 설계	●		●				서울
	R&D_기구 R&D_Material	- System/Component Design : 최적 구조 설계, 재질/표면처리 고려 부품 설계 - Design Verification : 충격 해석, 구조 분석, 열해석, M-CAD/3D Printer 활용 - 표면처리/성형/소재		●		●			서울
	R&D_SW	- Android 기반 Framework/App 개발 : Multimedia, Telephony, Security 등 - 무선통신 Protocol : Radio/Data/RF SW(5G), Connectivity 개발 - BSP : Linux Kernel, Device Driver, Power management 개발	●		●				서울
HE사업본부 (Home Entertainment)	R&D_SW	- SW플랫폼(webOS) 설계, Middleware, Application, SW 보안 설계 - 방송수신, 신호처리, 유무선 네트워크 처리, 미디어 플레이어 관장	●		●				서울/평택
	R&D_HW	- 제품 회로 설계 업무로서 방송 수신부, Video, 오디오 신호처리 설계, 그에 따른 Power(전력) 설계 및 회로 해석	●						평택
	R&D_기구	- 각종 디스플레이 제품의 기구 구조와 연관된 기술을 개발하며 기구 구조 설계, 분석, 열해석, 소재 발굴, 표면 처리, 광학 개발 등을 담당		●		●			평택
VC사업본부 (Vehicle Components)	R&D_SW	- EV(Electric Vehicle)용 부품 제어SW, SW 품질 관리, Test Manager - IV(In-Vehicle Infotainment) Application S/W, Connectivity(USB, Bluetooth, Wifi), OS, ADAS, Vision 알고리즘	●		●				서울/인천
	R&D_HW	- Motor, Inverter, Converter, Power Electronics, SoC Design, 센서제어 등 - IV(In-Vehicle Infotainment)HW개발, 고전압 시스템 회로설계, 차량용램프 전장설계 H/W 시스템, EMC/EMI 설계, LCD/OLED 회로/Interface 등	●					● (자동차)	서울/인천
	R&D_기구	- 모터 및 고전압 대용량 인버터/컨버터 기구 설계 - 배터리 모듈/팩 기구 설계 및 제작, 열관리 시스템 설계, Drive Unit 구조 설계 등 - 차량용 Lamp 구조 및 광학 설계		●				● (자동차)	서울/인천
B2B사업본부 (B2B Company)	R&D_SW	- SW Architecture - SW Platform · webOS Core / Web technology / Security / Media Streaming / SDK / BSP / Linux Kernel / Compiler - Data Mining & Analysis · Data collection / ETL / Dashboard / Design & Establishment of Data Service Platform	●		●				서울/평택
	R&D_HW R&D_기구	- Monitor Signage · Image Processing & Computer Vision · Speech & Audio Processing · Virtual / Augmented Reality (VR / AR) · Mechanical Design / BLU Design / CAE	●	●					평택
CTO부문 (Chief Technology Officer)	R&D_SW	- Application, Middleware, Network, OS Kernel, SW Engineering, Platform 등	●		●				서울
	R&D_HW	- Analog/Digital Circuit Design, CMOS Integrated Circuit, Electric Machinery - Motor, Inverter, Converter, Power Electronics, SoC Design, 센서제어 등	●		●				서울
	R&D_기구	- 유체 제어기술, Aeroacoustics, Fan&Flow설계, 열교환기, 감성진동소음, 구조진동/회전 등 - 고전압 대용량 인버터/컨버터 기구 설계 및 모터 개발	●	●		●			서울
	Content & Service	- 빅데이터 분석 과제 발굴, 분석 서비스/컨설팅 - 빅데이터 분석 플랫폼 개발, 운영 - 빅데이터 기반 B2B 솔루션화 및 사업화 추진	●		●			● (통계)	서울
소재/생산기술원 (Materials & Production Engineering Research Institute)	R&D_SW	- 장비운영 SW, 제어 알고리즘 개발, 영상처리 SW, Machine Vision	●		●				평택/청주/구미/울산
	R&D_HW	- 장비 운영SW, 제어 알고리즘, 영상처리, Machine Vision, 로보틱스 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징	●						평택/청주/구미/울산
	R&D_기구	- 장비 설계, Lay Out 설계, 정밀 구동부/강성 구조설계, 광학 모듈 설계 - 로보틱스, 구조/충격/강성 해석 및 최적 설계, 열유동/진동소음 설계 및 해석 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징			●				평택/청주/구미/울산
	R&D_Production R&D	- 생산시스템 설계/검증, 생산전략 수립/계획 최적화, 제품 Architecture 표준 설계/개발 - 제조지능화 솔루션(Big Data, AI, 머신러닝, 딥러닝 기반), 제조 ICT 플랫폼 - 금속/글라스 가공 기술, 플라스틱 및 복합소재 개발/응용, CMF 기술 - 생산요소기술(용접/주조/제철/실링 등), 청정환경솔루션(이물제어, 클린룸 등)	●	●	●	●		● (산업공학)	평택/청주/구미/울산
	R&D_Material&Device	- 센서, 복합 신소재, 광학, 차세대 디스플레이 - 금속, 나노 소재, 물성분석, 방열, 단열 소재 개발 등	●			●		● (이공계)	서울
CFO (Chief Finance Officer)	Finance	- 회계, 금융, 세무, 통상, IR, 경영관리, 경영전략, 기획관리, 보험 등						● (상경계)	서울/인천/평택/청주/구미/창원
	IT	- 사내 업무수행에 필요한 IT시스템 구축/운영 - 신기술(AI, Big Data, Cloud 등)을 활용한 사업지원형 시스템 구축 - 시스템 기반의 P(Process Innovation)와 Smart Working 환경 구축 - IT인프라 및 정보보안 관련 시스템 구축/운영			●			● (IT보안, 수학통계)	서울
	HR	- 인사: 인재확보, 인력운영, 평가 보상, 조직 설계 - 육성(교육): 리더십/직무역량 개발, 글로벌교육 - 노경: 노경환경 분석 및 전략 수립, 노조사업협의체와의 Comm.	●	●	●	●	●	●	전국
한국영업본부 (Korea Sales & Marketing)	Sales	- B2B: 건설, 조달 직영업 및 유통채널 관리, 공조시스템, 신사업(사이니지, 슬라, 솔루션 등) 기술영업 - B2C: 베스트샵, 대형유통, 온라인 영업 및 지점별/상권별 특성에 맞는 유통채널 관리 - 모바일: 통신사업자(LG U+ 등) / 직영채널 / 대리점 영업 및 관리	●	●	●	●	●	● (전공무관)	전국

※ CTO, 소재기술원 및 H&A사업본부 서울사업장은 석사 이상만 지원 가능
 ※ 해외영업직군은 한국영업본부에서 일정 기간 근무한 인력 중 우수인원을 선발하여 배치함
 ※ 당사 채용계획에 따라 본인이 지원하지 않은 본부/직무로 검토될 수 있음

*상기 내용은 당사 채용행사를 위한 자료이므로, 당사의 허락을 받지 않은 전체 또는 일부 자료에 대한 무단복제 및 재배포 등을 금합니다.